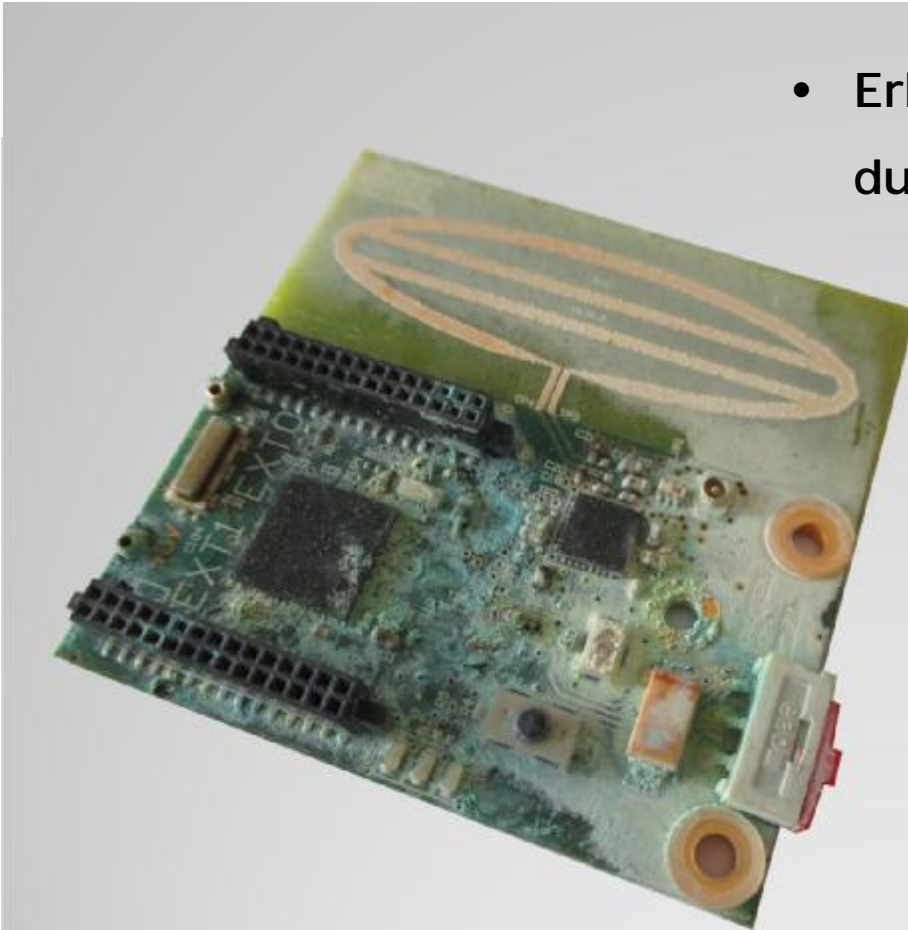




## **64. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie**

# So nicht!

## Gründe für eine BG Reinigung und Passivierung



- Erhöhung der Langzeitstabilität durch Schutz gegen Umwelteinflüsse (Staub, Feuchte, Vibrationen)
- Verbesserung von Isolationswiderständen
- hohe Anforderungen von HF-Schaltungen oder Ex-geschützten Baugruppen

# Voraussetzungen für eine Lackierung

Die Physik setzt die Grenzen!



- Abmessungen der Baugruppe (Länge – Breite – Höhe)
- Bauteile müssen für eine Reinigung geeignet sein
  - Baugruppenlayout
  - Kapillareffekte
  - Kompatibilität von Baugruppe und Lack



# Unsere Baugruppenreinigungsanlage

## Kolb PSB500 H50



- vollautomatischer Reinigungsautomat mit eigener VE-Wasser Aufbereitung
- Prozesskammer mit 2 Körben und Platz für 176 Baugruppen
- Baugruppengröße bis 450 x 400 x 200mm<sup>3</sup>
- Reinigen - Spülen - Klarspülen - Trocknen als freiprogrammierbare Prozesse mit permanenter Überwachung
- Reinigungsmedium Zestron A201

# Unsere Lackieranlageanlage

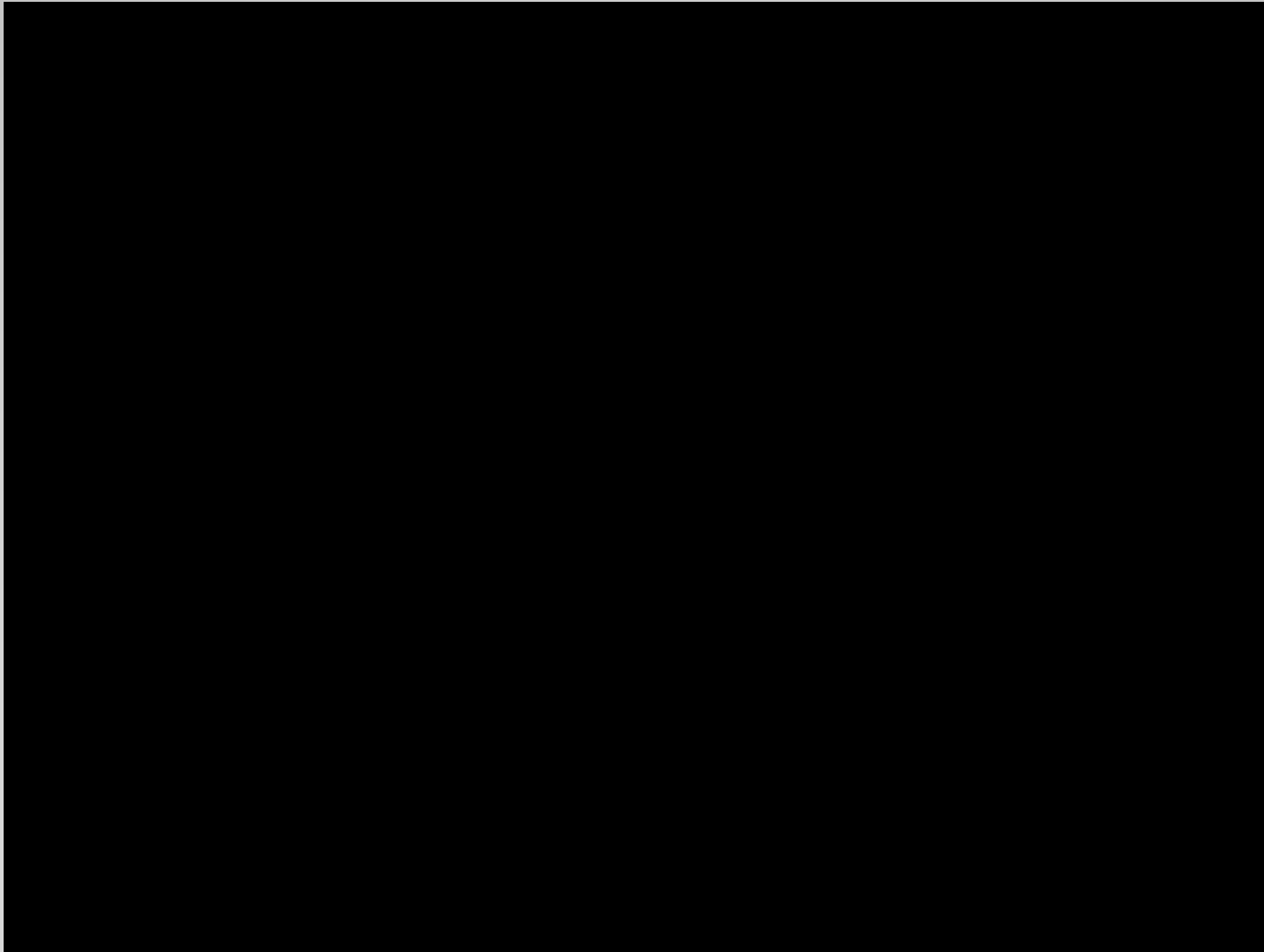
## DIMA HC200



- 4-Achsen Lackierkopf + Winkelstellung der Ventile
- Rotation des Lackierkopfes um 380° möglich
- max. Baugruppengröße 355 x 600mm<sup>2</sup>
- Freiraum unten / oben je 100mm
- Referenzmarkenerkennung für höchste Präzision
- gleichzeitiges verarbeiten von 2 verschiedenen Medien möglich
- permanente Prozessüberwachung
- Inline-fähig

# Unsere Lackieranlageanlage

## DIMA HC200



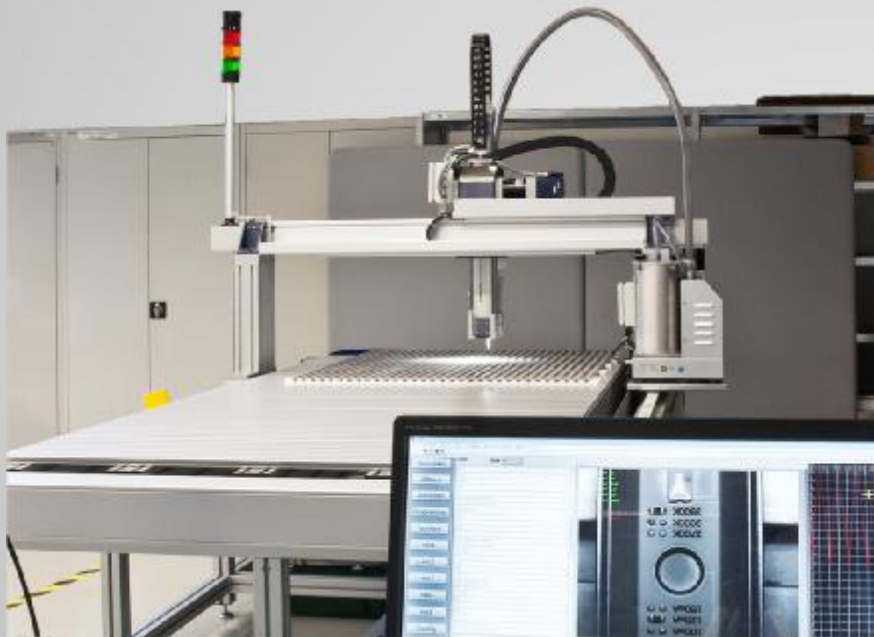


# Unsere Vergussanlage

## 3dDispenser 213



- 3 Achsen Vergusskopf mit integrierter Kamera – frei Konfigurierbar
- Aufspannfläche von 2450 x 1200mm<sup>2</sup>
- Arbeitsfläche von 2100 x 1100mm<sup>2</sup>
- Freiraum oben 300mm



- individuelle Objekterkennung
- Förderanlage mit 5L-Tanks - evakuierbar
- Verarbeitung von 2K-Silikon (glasklar)
- weitere 1K / 2K Medien möglich

## Breites Spektrum für (fast) alle Anwendungen key facts



- vollautomatische Baugruppenreinigung nach Ihren Ansprüchen
- Ultraschallreinigung für besondere Anforderungen
- Baugruppenlackierung vollflächig – selektiv – Damm and Fill
- selektiver Verguss / Underfill
- Portalanlage für großvolumige und großflächige  
Dosieranwendungen
- ...???



## **64. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie**



**Fragen?**

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**